

Products Guide

製品のご案内

浮き検査測定装置

高速解析

短時間検査

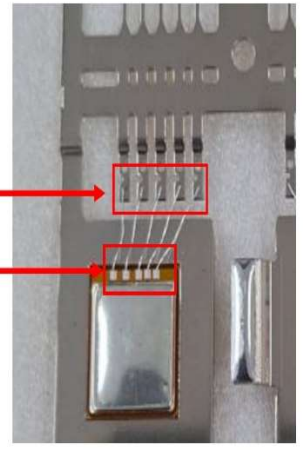
半田浮き検査装置

Solder Lift Inspection System

3D高さ計測で高精度検査を実現



■ サンプル



概要

本装置はワイヤーの半田部分の浮き検査を高速高精度で行います。潰れ高さを測定する事により、電気的な非導通の検査をいたします。色収差共焦点原理を用いた高精度の超高速センサーにより、最大 36000 ライン/秒の測定速度で、ライン当たり測定点数最大 1,200 点測定が可能です。測定精度は±2μm。また他の部位の段差、異物、キズ、突起、膜厚なども大面積で短時間検査測定する事が可能になります。測定ワークも選ばず鏡面でも測定可能です、センサーの入射光と検出光は同じ経路をたどるためシャドーイングを無視出来るので複雑な形状でも正確に測定できます。卓上機から、全自動型24時間インラインにも容易に対応致します。

装置構成例

構成 (一例)

1. 電動X、Yステージ
2. 手動Zステージ
3. サンプル保持用治具
4. 光学系取付架台
5. 測定及び制御用パソコン
6. 専用対物レンズ群
7. モーターコントロールボード
8. LCDディスプレイ

装置仕様

- 測定速度(1秒あたりのライン数) 最大 3600
- ライン長: 2.36 mm~11.9 mm (レンズ交換)
- 測定範囲 (Z方向): 0.68 m~10.6 m (レンズ交換)
- 開口数 (NA): 0.77~0.22 (レンズ交換)
- ライン当たり測定点数: 1200
- Z方向分解能: 0.8 μm (レンズ交換)
- 測定可能角度: 90° ±50° ~ ±13° (レンズ交換)
- 重量: 約 6.2 kg (センサー部)
- 大きさ: 346 × 185 × 135mm (センサー部)

測定検査例

